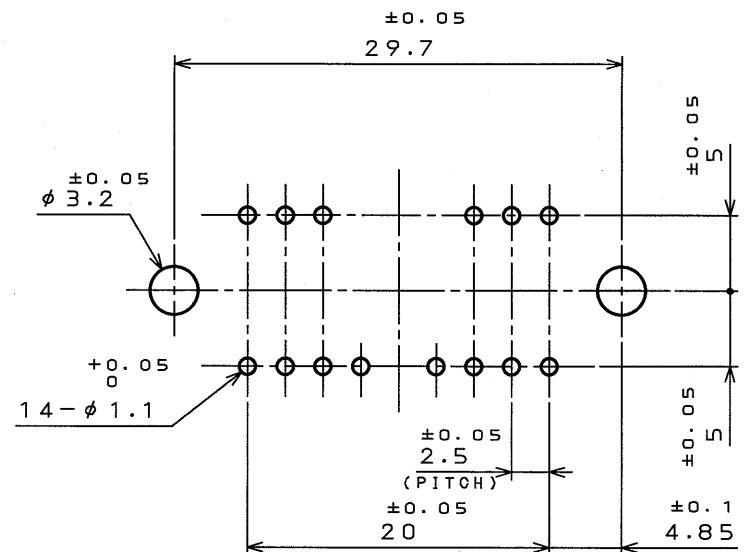
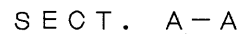
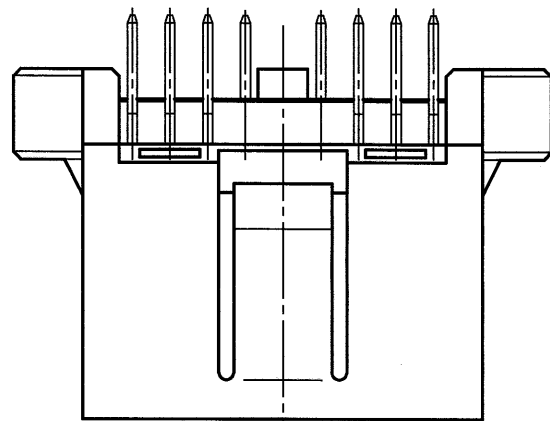




基板厚 t 1.6

- 注 1. 金型マークを浮き出す。
2. 社標を浮き出す。
3. 材料マークを浮き出す。
4. コンタクト先端部に、メッキは付かない。

CDS-01-110-10273

SIZE

版数
(REV.

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.